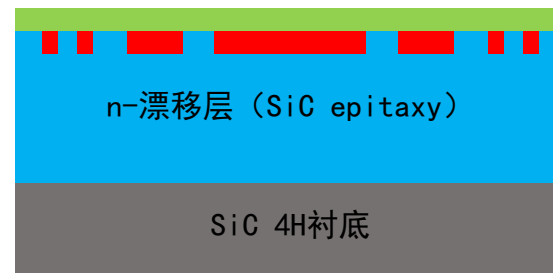




①基础外延结构



②离子注入 (有源区 + 保护环)



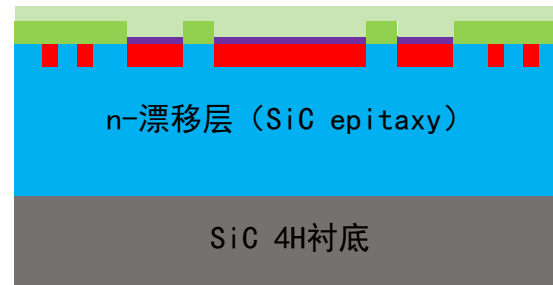
③注入激活退火+钝化层生长



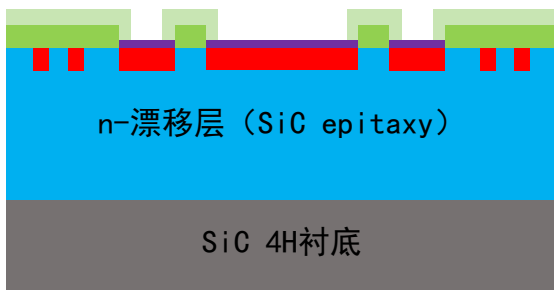
④刻蚀钝化层, 打开欧姆接触窗口



⑤溅射欧姆接触金属 (Ni/Ti/Al)



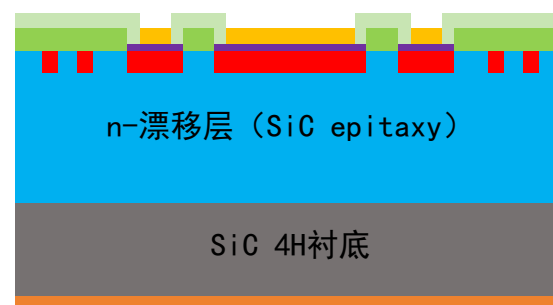
⑥沉积钝化介质层 (SiO₂ /Si₃ N₄)



⑦刻蚀钝化层, 打开 PAD 金属接触孔



⑧沉积 PAD 金属 + 场板 (Ti/Ni/Au)



⑨衬底减薄 + 背底金属沉积